

深圳市联得自动化装备股份有限公司

投资者关系活动记录表

证券简称：联得装备

证券代码：300545

编号：2025-011

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☒其他 券商策略会
参与单位名称及人员姓名	第一场：鹏华基金共 2 人 第二场：诺安基金、华福证券、卓臻基金、华美国际投资共 7 人 第三场：博时基金共 1 人
时间	2025 年 8 月 29 日
地点	券商策略会现场（深圳）
上市公司接待人员姓名	董事、董事会秘书：刘雨晴女士
投资者关系活动主要内容介绍	一、介绍公司概况 简要介绍公司及子公司发展历程、主营业务、近年主要经营业绩，公司及子公司的核心优势及未来发展规划等情况。 二、投资者会议问答交流 Q1：请介绍一下公司的主要产品有哪些？ A1：公司主要从事新型半导体显示智能装备、汽车智能座舱系统装备、半导体封测设备、新能源设备的研发、生产、销售及服务。公司主要产品包括绑定设备、贴合设备、偏贴设备、覆膜设备、检测设备、大尺寸/超大尺寸 TV 模组整线设备、移动终端自动化设备、汽车智能座舱系统组装设备、超精密点胶及 3D 点胶设备、Mini/Micro LED 芯片分选设备、扩晶设备、真空贴膜设备、巨量转移设备、高精度拼接设备、半导体倒装设备、固晶设备、AOI 检测设备、引线框架贴膜设备、钙钛矿光伏涂布/VCD/HP 等设备、锂电池模切叠片设备、电芯装配段及 Pack 段整线自动化设备。

Q2：公司在半导体设备领域有哪些布局？

A2：在半导体设备领域，公司专注于研发、制造、销售半导体后道工序的封装测试设备。公司抓紧在手项目的落地，加快半导体设备领域的产品突破和产业化进程，已完成高精度显示芯片倒装键合机、高速共晶固晶机、软焊料固晶机、AOI 检测、Mini LED 芯片分选机、Mini LED 贴膜机、引线框架贴膜和检测设备的研发，并形成销售订单。基于在半导体固晶机领域的研发基础和技术积累，公司已经具备共晶、软焊料、Flipchip、刺晶等半导体固晶工艺技术和关键设备研发生产能力，拥有直线式、刺晶式、倒装固晶机相关技术专利。同时，在半导体材料的细分领域，引线框架生产检测设备上也有布局，已批量交付引线框架贴膜机、引线框架 AOI 检测机等。公司也在积极调研和拓展倒装封装、系统级封装、面板级封装、晶圆级封装、2.5D/3D 封装等先进封装制程和第三代半导体相关高端装备，研究设备工艺技术，布局相关设备底层软件、算法、运控、人工智能和机器视觉技术，自主研发设备关键核心模组及其零部件，使公司在半导体设备领域的核心技术竞争力得到进一步巩固和夯实，进而推动半导体业务板块规模的增长。

Q3：公司的设备应用在手机折叠屏领域发展情况如何？

A3：公司柔性 AMOLED 贴合类设备已经广泛运用国内外知名终端客户手机折叠屏的量产。公司与国内外多家智能手机知名品牌制造商保持良好的合作关系，并持续就柔性屏创新性作用开展深入合作。在三折屏供应链中，公司提供的贴合类工艺设备已形成销售订单并出货。公司作为折叠屏贴合类设备相关细分市场的领先企业，持续发挥技术领先优势。

Q4：公司在固态电池及新能源其他业务方面有哪些布局？

A4：在新能源设备领域，公司持续增加在锂电池包蓝膜、固态/半固态电池超声焊接、切叠一体机、电芯装配及 Pack 段整线自动化设备等设备上的研发投入，运用先进的生产工艺、高精度的生产方式、标准化管理，迅速实现产品突破，并形成销售订单。同时，公司积极布局钙钛矿相关工艺设备的研发，在 GW 级涂布设备、VCD 设备和 HP 设备的研发生产方面取得新突破。固态电池新工艺涉及到的超声波焊接工艺设备已经出货到客

	户。 Q5：公司在 VR/AR/MR 显示领域主要的产品和客户有哪些？ A5：公司通过持续创新，打破技术壁垒，研发的设备已经赢得了 VR/AR/MR 等新型显示领域客户的青睐。在 VR/AR/MR 显示设备领域，公司提供其显示器件生产工艺中所需的设备，涵盖硅基显示、光波导贴合等众多工艺段，相关产品已与合肥视涯及国际头部终端客户建立了合作关系。 Q6：公司是否考虑通过并购重组来扩大经营？ A6：公司一直持续关注相关行业动态，积极寻求整合优质资源的机会，将充分把握中央及地方监管机构支持上市公司并购重组、加强产业整合的政策导向，公司将根据自身发展战略规划、市场需求、行业前景等方面审慎决策。
附件清单（如有）	无
日期	2025-8-29